

V Bruseli 21. novembra 2018
(OR. en)

14559/18
ADD 1

ENV 797
MI 870
DEFACT 153

SPRIEVODNÁ POZNÁMKA

Od:	Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie
Dátum doručenia:	19. novembra 2018
Komu:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generálny tajomník Rady Európskej únie
Č. dok. Kom.:	C(2018) 7499 final - Annex
Predmet:	PRÍLOHA k delegovanej smernici Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo v spájkach na zostavenie stabilného elektrického spojenia medzi polovodičovým čipom a nosičom v rámci súprav integrovaného obvodu Flip Chip

Delegáciám v prílohe zasielame dokument C(2018) 7499 final - Annex.

Príloha: C(2018) 7499 final - Annex



EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 16. 11. 2018
C(2018) 7499 final

ANNEX

PRÍLOHA

k

delegovanej smernici Komisie,

ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo v spájkach na zostavenie stabilného elektrického spojenia medzi polovodičovým čipom a nosičom v rámci súprav integrovaného obvodu Flip Chip

PRÍLOHA

V prílohe III sa záznam 15 nahrádza takto:

„15	Olovo v spájkach na zostavenie stabilného elektrického spojenia medzi polovodičovým čipom a nosičom v rámci súprav integrovaného obvodu Flip Chip	Platí pre kategórie 8, 9 a 11 a platnosť uplynie: – 21. júla 2021 v prípade kategórií 8 a 9, iné ako diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro a priemyselné monitorovacie a kontrolné prístroje, – 21. júla 2023 v prípade kategórie 8, diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, – 21. júla 2024 v prípade kategórie 9, priemyselné monitorovacie a kontrolné prístroje, a v prípade kategórie 11.
15 a)	Olovo v spájkach na zostavenie stabilného elektrického spojenia medzi polovodičovým čipom a nosičom v rámci súprav integrovaného obvodu Flip Chip, ak je splnené aspoň jedno z týchto kritérií: – technologický uzol polovodiča je 90 nm alebo viac, – jednotlivý čip s plochou 300 mm² alebo viac v ktoromkoľvek technologickom uzle polovodiča, – zostavy s vrstvenými čipmi s plochou čipu 300 mm² alebo viac, alebo kremíkové vložky s plochou 300 mm² alebo viac.	Platí pre kategórie 1 až 7 a pre kategóriu 10 a platnosť uplynie 21. júla 2021.“